

整面型透明封裝膠材技術

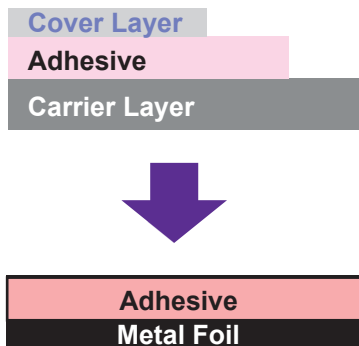
技術特色

本技術為一種軟性OLED封止用熱硬化型組成物，此組成物在整面封止時不會對OLED產生不良的影響，除了能夠抑制有機電激發光元件暗點的發生外，更具有良好的撓曲性，以及對基材有優異的附著力等表現。

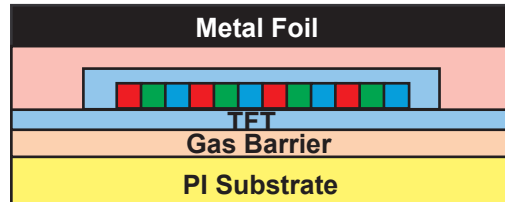
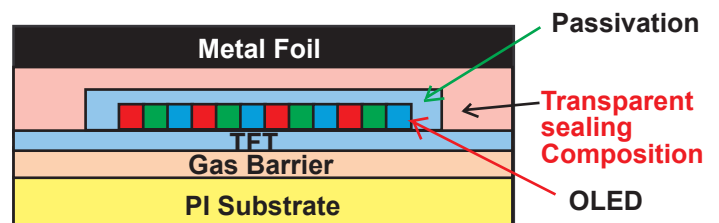
技術規格

- ◆ 玻璃轉移溫度： $\geq 90^{\circ}\text{C}$
- ◆ 穿透度： $\geq 98\%$
- ◆ 對PI基材抗撕強度： $\geq 1.0\text{Kg}/2.5\text{mm}$
- ◆ 揚氏模數： $\leq 10\text{Mpa}$
- ◆ 體積收縮率： $\leq 1\%$

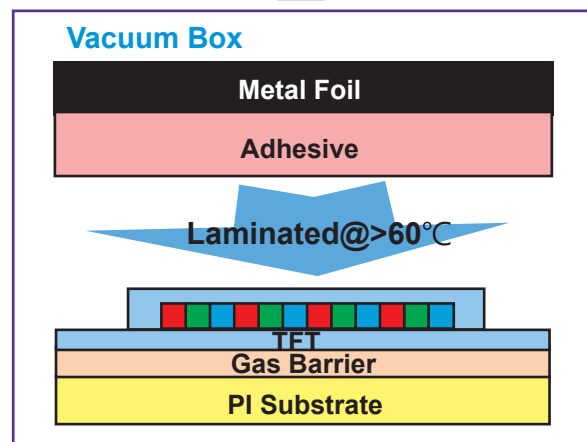
Adhesive Transfer on Metal Foil or Flexible Substrate



The Transparent Encapsulation Materials for Flexible OLEDs



Finish



Lamination with Backplane

產業應用

- ◆ 大尺寸OLED顯示器
- ◆ 軟性OLED顯示器或照明
- ◆ 觸控模組

